【19】中華民國

【12】專利公報 (U)

【11】證書號數:M642867

【45】公告日: 中華民國 112 (2023) 年 06 月 21 日

[51] Int. Cl.: B23Q5/54 (2006.01) B23P21/00 (2006.01)

新型 全9頁

【54】名 稱: 切削加工裝置

【21】申請案號: 112200251 【22】申請日: 中華民國 112 (2023) 年 01 月 09 日

【72】新型創作人: 黃仁清 (TW) 【71】申 請 人: 東南科技大學

新北市深坑區北深路三段 152 號

【74】代理人: 李世達

【57】申請專利範圍

1. 一種切削加工裝置,包含:

- 一底座,具有一主體部以及一延伸部,其中該延伸部係自該主體部之一端向上延伸;
- 一 L 型懸臂, 具有一水平部以及一垂直部, 其中該垂直部之一端係固定於該主體部之另一端:
- 一切削模組,具有一滑動件、一連接件以及一刀具,其中該連接件分別可拆卸地連接該滑動件與該刀具,且該滑動件具有一通孔而可套在該水平部上進行水平移動;
- 一測力感測器,與該延伸部連接;以及
- 一可移動載具,置於該主體部上並與該測力感測器連接;

其中,當該可移動載具上放置一工件時,該切削模組藉由該滑動件在該水平部上水平移動而移向該工件,並以該刀具切削該工件。

- 2. 如請求項1所述之切削加工裝置,其中該滑動件係藉由一第一卡合件與該連接件可拆卸 地卡合。
- 如請求項1所述之切削加工裝置,其中該刀具係藉由一第二卡合件與該連接件可拆卸地 卡合。
- 4. 如請求項1所述之切削加工裝置,更包含:一斷屑器,其中該斷屑器係藉由一第三卡合件與該刀具可拆卸地卡合。
- 5. 如請求項1所述之切削加工裝置,其中該刀具係金屬、木頭或塑膠。
- 6. 如請求項1所述之切削加工裝置,其中該刀具有一刀面以及一底面,且該刀面與該底面 之間具有一銳角。
- 7. 如請求項1所述之切削加工裝置,其中該工件之材料為油土或黏土。
- 8. 如請求項1所述之切削加工裝置,其中該工件係由一長方體模所製成,且所有表面皆印上墨水。
- 9. 如請求項1所述之切削加工裝置,其中該延伸部係與該底座垂直。
- 10. 如請求項1所述之切削加工裝置,其中該水平部之高度大於該延伸部之高度。

圖式簡單說明

圖 1 係繪示本創作一實施例之切削加工裝置立體圖。

- 圖 2 係繪示本創作一實施例之切削加工裝置側視圖。
- 圖 3 係繪示本創作一實施例之斷屑器示意圖。
- 圖 4 係繪示本創作一實施例之切削模組立體圖。
- 圖 5 係繪示本創作一實施例之切削模組側視圖。

圖6係繪示本創作一實施例之切削模組的連接件立體圖。

圖 7 係繪示本創作一實施例之刀具立體圖。

圖 8 係繪示本創作一實施例之切削模組的刀具側視圖。

<u>1</u>

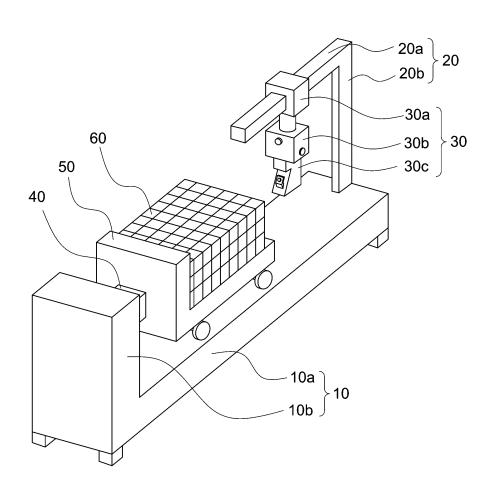


圖1

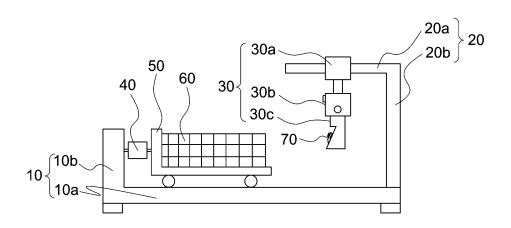
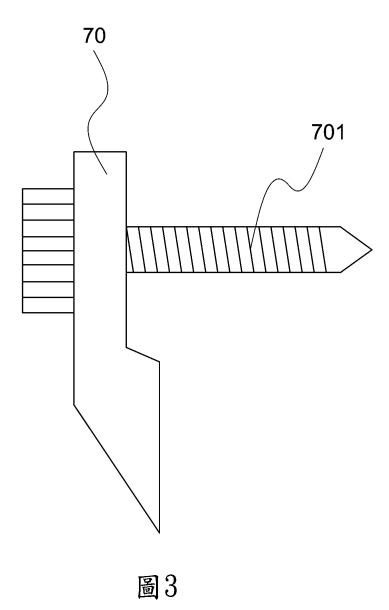


圖2





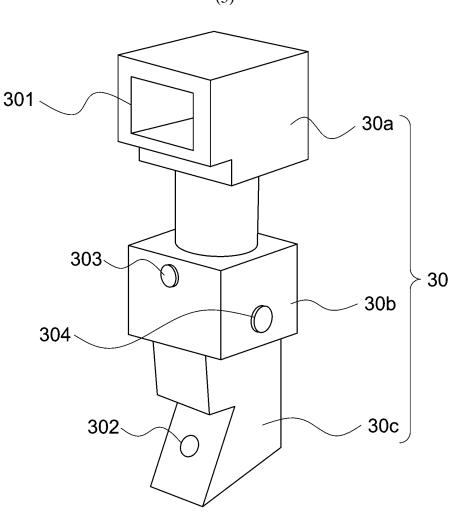


圖4

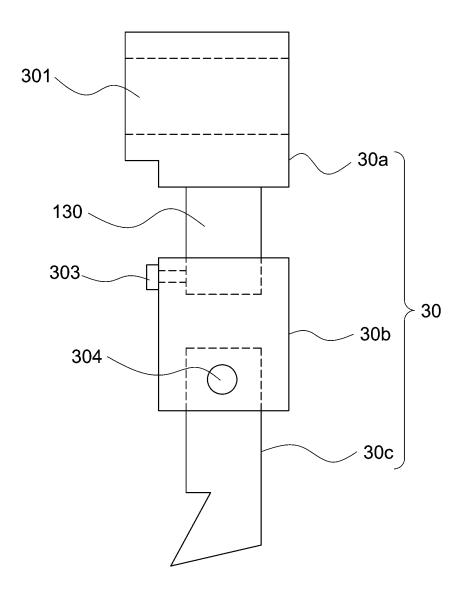


圖5

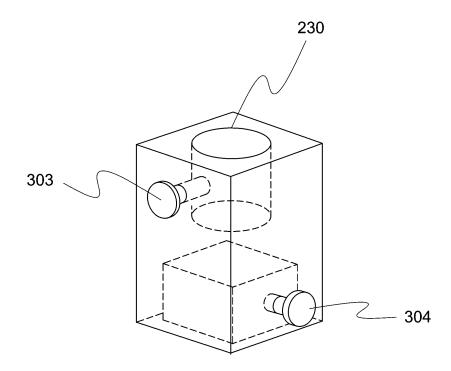


圖6

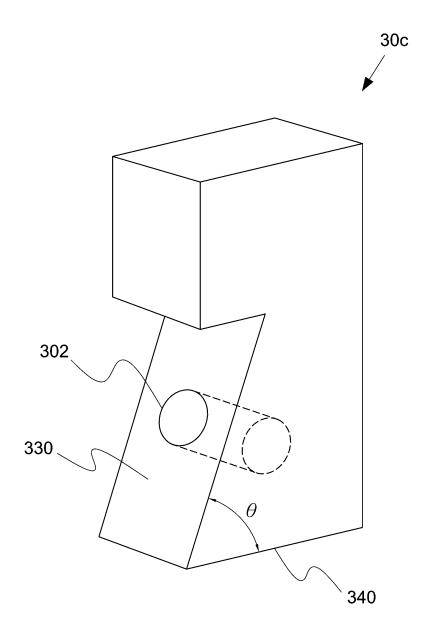


圖7

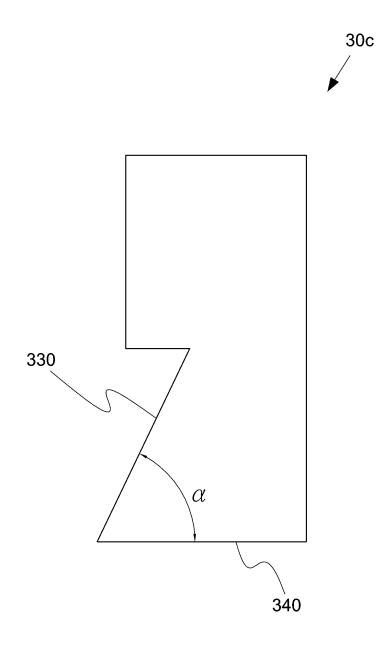


圖8